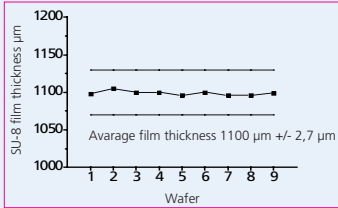
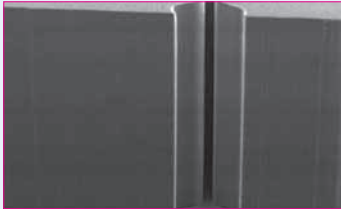


Die Experten für Photoresiste

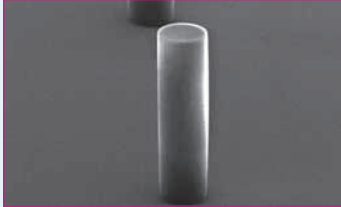
Innovation



Schichtdicken in einer Serie SU-8 beschichteter Wafer mit excellenter Reproduzierbarkeit



Herstellung einer 1000 μm Resistschicht



UV Strukturierte 300 μm hohe SU-8 Schicht



UV Strukturierte 30 μm hohe Spule



Galvanisch abgeschiedene Nickelspule 30 μm



Mikrowellen-Plasmaprozessor TEPLA 300 SEMI AUTO

Qualität

Service

Know-how

Analytische Dienstleistungen

- UV/Vis- und NIR-Spektroskopie von Lösungen und Schichten
- Rasterelektronenmikroskopie – Abbildung von Oberflächen bis 30000-fache Vergrößerung

Photoresist-Modifizierung

- ORMOCER®e mit verändertem Polymerisationsinitiator
- ORMOCER®-Lösungen nach Kundenwunsch (Schichtdickenvariationen)
- Resistlösungen auf Epoxy-Basis (SU-8) nach Kundenwunsch (z.B. Lösemittelvariationen)
- Gefärbte Photoresistlösungen

Lithographische Dienstleistungen

- Beschichtung von Substraten (z.B. Silizium, Glas, Keramik, Folien) mit Photoresisten/Polymeren
 - Spincoating (5 Zoll)
 - Rakeln (15 cm x 30 cm)
- Herstellung von ultradicken Resistschichten
 - Positiv - Photoresiste von 1 μm bis 60 μm
 - Epoxies (SU-8) von 0,5 μm bis 1500 μm
- Innovative Trocknungsprozesse unter Verwendung eines Infrarot-Ofens (4" – 6" Wafer)
- UV-lithographische Strukturierungen (4" Wafer)
 - SU-8-Schichten bis zu 300 μm
 - Positiv - Photoresistschichten bis zu 50 μm
 - Negativ - Photoresistschichten bis zu 10 μm

O₂-Plasma-Prozessierung

- Serviceleistungen am Mikrowellen-Plasmasystem (TEPLA)
- Entfernung von Photoresisten und Polymeren

Lithographische Ausrüstung

- Mikrowellen-Plasmaprozessor TEPLA 300 SEMI AUTO
- Beschichtungssysteme mit und ohne Gyset bis Substratgrößen von 5"=
- Trocknungssysteme
 - Programmierbare Präzisionsheizplatten
 - Infrarot-Ofen
 - Konvektionsöfen
- Belichtungssystem Maskaligner SÜSS MA 56 M
- Schichtdickenmeßgeräte
 - DEKTAK (Profilometer) für Schichten bis zu 300 μm
 - FTP 500 (Ellipsometer) für Schichten bis zu 3 μm
- Galvanische Nickel - Abscheidung bis 80 μm Schichthöhe (Ni-Sulfamate) für 4"- Wafer